

[Aufbau - und Verbindungstechnik]

Für die Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte wie z.B. Smartphones sind heute Technologien zur Erhöhung der Integrationsdichte und Systemintegration Voraussetzung. Die Anforderungen an Komponenten wie Leiterplatten und somit an die Fertigung haben sich in den letzten Jahren extrem gewandelt.

Ziel des Workshop ist es, einen Überblick über die neusten Entwicklungen im Bereich des Packaging zu geben. Neben allgemeinen Trends in der Aufbau- und Verbindungstechnik werden auch spezielle Verfahren und Bereiche wie z.B. die Leiterplattenfertigung im Detail vorgestellt. Der Schwerpunkt wird in diesem Jahr nicht nur auf die optischen Anwendungen sondern auch auf die elektronischen Aspekte der AVT gelegt.

So wird z.B. das Drucksintern als Verfahren für leistungselektronische Komponenten aber auch das Design und der Aufbau von optoelektronischen Leiterplatten vorgestellt .

Der Workshop richtet sich sowohl an Entwickler als auch an Anwender aus den Bereichen Laser Packaging, Optik, Elektronik und Mikrosystemtechnik.



[Anfahrt]

**ILFA Industrieelektronik und
Leiterplattenfertigung aller Art GmbH**
Lohweg 3
30559 Hannover

Hier geht es zu [google maps](#):



[Veranstalter]

PhotonicNet GmbH

Dr.-Ing. Thomas Fahlbusch
Tel.: 0511 / 277-1640
fahlbusch@photonicnet.de

[in Kooperation mit]

ILFA GmbH

Dr. Andreas Gombert
Tel.: 0511-959 55 3047
A.gombert@ilfa.de

Photonic-Net

Innovationsnetz Optische Technologien

IN KOOPERATION MIT:

ILFA 
FEINSTLEITER
TECHNOLOGIE

AVT
Aufbau- und
Verbindungstechnik

[Hannover
18. Oktober 2017]



[Programm]

Begrüßung der Teilnehmer **09:30 Uhr**

Dr.-Ing. Thomas Fahlbusch
PhotonicNet GmbH, Hannover

Trends und Herausforderungen der AVT **09:40 Uhr**

Prof. Dr. Jürgen Wilde
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK),
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

**Entwicklungstrends in der
Leiterplattentechnologie** **10:10 Uhr**

Dr. Andreas Gombert
ILFA Industrieelektronik und Leiterplattenfertigung aller Art
GmbH, Hannover

Kaffeepause **10:40 Uhr**

**Drucksintern aktiver und passiver
leistungselektronischer Komponenten** **11:10 Uhr**

Prof. Dr. Ronald Eisele
Institut für Mechatronik, Hochschule für angewandte
Wissenschaften Kiel

**Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
in der elektronischen Baugruppenfertigung** **11:40 Uhr**

Andreas Kraus
Kraus Hardware GmbH, Großostheim

Mittagspause **12:10 Uhr**

Gedruckte Polymer-Lichtwellenleiter **13:15 Uhr**

Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer
Institut für Transport- und Automatisierungstechnik (ITA)
Leibniz Universität Hannover

**Design and Packaging of
Electro-Optical Circuit Boards** **13:45 Uhr**

Daniel Weber
Fraunhofer - Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration IZM, Berlin

Kaffeepause **14:15 Uhr**

**Einsatz von Robotern in der
aktiven Montage von elektro-optischen
Komponenten** **14:45 Uhr**

Torsten Vahrenkamp
ficonTEC Service GmbH, Achim

**Inspektionssysteme für
elektronische und elektro-optische Leiterplatten** **15:15 Uhr**

Volker Pape
Viscom AG, Hannover

Besichtigung der ILFA GmbH **15:45 Uhr**

Ende der Veranstaltung **ca. 17:00 Uhr**

**Verbindliche Anmeldung bitte bis spätestens
09. Oktober an:**

Fax-Nr.: 0511 / 277 16-50 oder

ONLINE oder

E-Mail an: Veranstaltung@photonicnet.de

An dem Workshop nehme ich teil

Titel, Vorname, Name

Firma / Institution

Straße

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Mitglied im Innovationsnetz OT

Datum / Unterschrift

Veranstaltungsort:

ILFA Industrieelektronik und
Leiterplattenfertigung aller Art GmbH
Lohweg 3, 30559 Hannover

Teilnehmergebühr:

290,00 € (zzgl. 19% MwSt.).
Für Mitglieder der Innovationsnetze Optische Technologien
230,00 € (zzgl. 19% MwSt.).

Mit Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.